

## 전자 부품과 반도체 제조 촉진 제도

### 1.배경:

정부는 전자 하드웨어 제조에 높은 우선순위를 두고 있습니다. 전자 하드웨어 제조는 인도 정부의 "Make in India"와 "Digital India" 프로그램의 중요한 요소 중 하나이기 때문입니다. 현재 인도의 전자 제조 산업은 가치 사슬의 서로 다른 단계뿐만 아니라 전자 제조 분야의 경쟁 경제들에 비해 8 - 10%의 장해를 겪고 있습니다.

1.2 지난 몇 년 동안 국내 전자제품 제조는 상당히 증가했으며, 이것은 부분조립생산에서 완전해체조립 제조 단계로 꾸준히 이동하고 있습니다. 다만, 국내 부가가치는 10~30%대에 한해서도 낮은 수준을 지속하고 있습니다. 이는 전자부품 제조 생태계 부족, 반도체 제조 생태계 부재 하고 디스플레이 제조 생태계 부재로 인한 것입니다. 국내 전자제품 제조업의 주요 성장은 '수입 전자부품/하위 부품/부품 및국내 수요에 부응해서 완성품을 조립한 데 기인합니다.

1.3 공급망 개발은 국내 부가가치가 높은 전자제품의 제조에 필수적입니다. 2019 년 2 월 25 일에 발표된국가전자정책(NPE 2019)의 비전은 칩셋을 포함한 핵심 부품 개발을 위해 국가에서 역량을 장려하고 추진함으로써 업계가 전 세계적으로 경쟁할 수 있는 환경을 조성하여 인도를 전자 시스템 설계 및 제조(ESDM)의 글로벌 허브로 자리매김하는 것입니다.

1.4 전자 부품과 반도체의 제조는 자본 집약적이며 끊임없이 변화하는 기술에 대처해야 합니다. 구성 요소는 전자 제품의 핵심이며 제품 구성 사양(BOM)의 총 가치의 중요한 부분을 구성합니다. 활발한 전자 부품 제조 생태계는 인도에서 전자 제품 제조의 전반적인 장기적이고 지속 가능한 성장과 긍정적인 국제 수지(BoP)을 달성하는 데 필수적입니다.

1.5 전자부품/반도체 제조에 대한 투자유치의 주된 장애물로는 전자부품/반도체의 대부분이 WTO의 정보기술 협정(ITA-1)에 따라 적용되므로 "Nil" 기본관세(BCD)로 수입; 경쟁력있는 글로벌 규모의 역량을 구축하기위한 높은 자본 비용; 불충분한 기반 시설;적절하고 신뢰할 수 있는 양질의 전력 및 경쟁률의 급수 부족, 공급망 부족, 높은 물류 비용, 기술 부족 등 포함합니다.

1.6 수정 특별 인센티브 패키지 정책(Modified Special Incentive Package Scheme, M-SIPS)는 장애와 높은 선불 비용을 상쇄하여 전자제품 제조 분야에 대한 투자를 유치하기

# W-18/30/2019-IPHW-MeitY

## 전자정보기술부

### (IPHW 부서)

위한 재정적 인센티브를 제공하기 위한 계획으로 설계되었습니다. 이 계획은 2018년 12월 31일까지 신규 프로젝트와 확장 프로젝트에 대한 신청서를 받을 수 있도록 개방되었습니다. 이 제도는 전자 제조 시설의 설치를 위한 자본 지출 투자에 대한 보조금을 제공하였습니다(SEZ 장치에 설치된 장치의 경우 20%, SEZ 이외의 장치의 경우 25%). M-SIPS는 인도에서 전자제품 제조에 대한 투자를 촉진하는 데 중요한 역할을 했습니다.

## 2. 전자 부품과 반도체 제조 촉진 제도

2.1 전자부품 및 반도체의 제조촉진계획(SPECS)에 따라 전자제품의 공급망을 구성하는 부속목록에 따라, 상품 제조에 대한 자본지출의 25%의 재정적 인센티브를 제공하는 것을 제안합니다.

### 3 목적:

3.1 이 제도는 국내 전자제품 제조 생태계를 강화하기 위해 부품 및 반도체의 국내 제조에 대한 장애를 상쇄하는 데 도움이 될 것입니다.

### 4. 자격:

4.1 SPECS는 새로운 유닛에 대한 투자뿐만 아니라 용량/현대화 및 기존 유닛의 다양화에도 적용될 것입니다.

### 5. 허용 한계:

5.1 제도에 따라 적용 가능한 최소 임계값 투자가 부속되어 있습니다.

5.2 허용값은 신규 유닛 또는 용량/현대화 및 기존 유닛의 다양화의 확대에 대해 동일합니다.

5.3 인센티브가 제공되는 상품/기준의 변경과 관련하여 정기적인 검토가 수행됩니다.

## 6. 제도의 임기

6.1 SPECS는 통지일로부터 3년 동안 처음 응용 프로그램에 대해 개방됩니다. 이 계획에 따라 접수된 신청서는 지속적으로 평가되며, 해당 계획에 따라 합의된 승인에 따라 구현이 계속됩니다.

## 7. 제도에 따른 인센티브

7.1 첨부된 목록에 따라 상품에 대한 투자를 하는 부서에 대해서는 자본 지출에 대한 25%의 인센티브가 제공되어야 합니다. 인센티브는 변제 기준으로 제공됩니다.

7.2 자본 지출은 '연구개발(R&D)을 포함한 공장, 기계, 장비, 관련 유틸리티 및 기술 지출에 대한 총 지출입니다. 이러한 적격 자본 지출에 대한 세부 정보가 설명지침에 포함될

것입니다. 이와 관련하여 인센티브 계산을 위해 수입 또는 국내 조달 여부에 관계없이 전체 적격 공장, 기계 및 장비 (관련 유틸리티 및 R & D 포함)의 20 %를 초과하지 않는 개조 된 공장, 기계 및 장비 (관련 유틸리티 및 R & D 포함)의 총 가치를 고려해야 합니다.

7.3 주 정부 또는 그 기관이나 지방 기관이 제공하는 인센티브는 제안된 제도에 따라 자격이 있는 인센티브 이상이어야 합니다.

7.4 신청자는 인도 정부의 다른 제도에 따라 혜택을 받을 수 있습니다. 그러나 인센티브가 청구된 M-SIPS 제도에 따라 신청자들로 자행된 투자는 SPECS 제도에 따라 적격 투자로 인정되지 않습니다.

## 8. 승인 및 지출 과정

8.1 이 제도에 따른 신청은 인도에 등록된 모든 기관이 할 수 있습니다.

8.2 모든 신청서는 새로운 투자와 독립적인 신청서로 간주됩니다. 신청은 단상 프로젝트에만 적용되어야 하며, 단계적 적용은 이 제도에서 고려하지 않습니다. 신청자가 다중 신청 및 여러 장소로 신청을 할 수 있습니다.

8.3 모든 측면에서 완료되고 마감일 전에 제출된 초기 신청서는 지속적으로 평가되고 승인을 위해 검토됩니다.

8.4 이 계획에 따른 인센티브는 신청서 접수일부터 적용됩니다. 신청서의 최초 검토 후 확인서가 발행됩니다. 신청서의 승인은 SPECS 에 따른 승인으로 해석되어서는 안 됩니다.

8.5 인센티브는 신청서 승인일로부터 5 년 이내에 이루어진 투자에 대해 이용할 수 있습니다. 적용 대상 자본 지출에 대한 인센티브는 신청서의 승인 후에 공개되어야 하며, 임계값을 초과하는 자본 지출과 상업적 생산의 개시를 조건으로 합니다. 인센티브에 대한 후속 청구는 6 개월 단위로 제출될 수 있습니다.

8.6 SPECS 에 따라 인센티브를 받는 그룹은 생산 개시일로부터 최소 3 년 또는 마지막 인센티브를 받은 날로부터 1 년 중 나중에 상업적 생산에 남아 있어야 합니다.

## 9 거버넌스 메커니즘

9.1 그 제도는 노달 기관(Nodal Agency)을 통해 시행되어야 합니다. 노달기관에서 신청서를 평가합니다.

## W-18/30/2019-IPHW-MeitY

### 전자정보기술부

#### (IPHW 부서)

9.2 그러한 노달 기관은 프로젝트 관리국(PMA)의 역할을 하며, 비서, 관리 및 실행지원을 제공하고, 수시로 MeitY 가 할당한 기타 책임을 수행할 책임이 있다. PMA 의 기능과 책임은 MeitY 에서 별도로 발행하는 제도 지침에 자세히 설명될 것입니다.

9.3 SPECS 및 PMA 구현과 관련된 수행하는 활동을 다음과 같습니다.

9.3.1 지원서를 접수하고, 승인서를 발급하고, 평가서를 작성하고, 제도에 따라 지원자의 지원 자격을 확인합니다.

9.3.2 지출 청구서를 검토하여 승인된 지원자에게 인센티브를 지급합니다.

9.3.4 제도의 진행 및 성과에 대한 정기 보고서를 MeitY 에 제출합니다.

9.4 PMA 는 전자 정보 기술부 (MeitY)가 구성하는 집행위원회 (EC) 전에 평가 및 승인 된 신청서를 제출합니다. EC 는 MeitY 에서 공동 비서 직급 이하의 담당자가 의장을 맡게 됩니다. EC 는 관련 부처/부서 및 조직의 대표자로 구성됩니다. EC 의 세부적인 헌법, 기능 및 책임은 Scheme Guidelines 에서 자세히 설명될 것입니다.

9.5 EC 는 신청서의 승인 / 거부 / 수정을 위해 PMA 를 권장합니다. EC 의 권장 사항에 따라 PMA 는 신청자에게 승인 서한을 MeitY 사본과 함께 발행해야 합니다.

9.6 MeitY 는 제도 하의 승인된 프로젝트에 대한 인센티브의 지출을 위한 예산 조항을 제정해야 합니다. 인센티브의 지출은 승인 조건과 재정 규칙에 따라 PMA 가 부담해야 합니다. PMA 는 프로젝트별로그가 아니라 정기적으로 MeitY 에 예산 요구 사항을 연결 금액으로 제출합니다.

9.7 이 제도의 진행 상황은 MeitY 사무국장이 주재하는 MeitY 가 구성할 집행이사회(GC)를 통해 검토될 것입니다. GC 는 정부와 업계의 전문가들로 구성될 것입니다.GC 는 정기적으로 제도의 진행 상황과 그 프로젝트의 진행 상황을 검토합니다. GC 는 제도의 성공적인 구현을 위해 제도 지침의 개정을 수시로 수행할 수 있습니다.GC 의 세부적인 헌법, 기능 및 책임은 S 제도 지침에 자세히 설명될 것입니다.

9.8 제도에 따른 인센티브를받을 수 있는 상품 목록은 집행이사회과 함께 수시로 검토 및 수정해야 합니다.

# W-18/30/2019-IPHW-MeitY

## 전자정보기술부

### (IPHW 부서)

9.9 SPECS 제도의 효과적인 기능을 위해, 평가 및 지출 지침은 MeitY 가 작성하고 별도로 발행해야 합니다.

9.10 이 제도에 대한 중간 평가는 명시된 목표의 관점에서 산업과 경제가 받는 이익을 평가하기 위해 수행되어야 합니다.

### SPECS 에 따라 인센티브를 받을 수 있는 상품 목록

#### A. INR 5 크로르 (656,708 USD)의 최소 투자 임계값 한계를 가진 상품 목록

번호	상품설명
1.	LED 칩을 포함한 SMT 부품
2.	칩 모듈 스마트 카드/ RFID 안테나 및 라벨/CoB/ 시스템 패키지
3.	전자적 용도를 위한 저항기, 콘덴서, 페라이트 등을 포함한 수동적 구성 요소
4.	전자용도를 위한 변압기, 유도자, 코일, 릴레이, 스위치, 마이크로 모터, 스테퍼 모터, BLDC 모터, 커넥터, 히트 싱크, 안테나, 스피커, 마이크로폰 등을 포함한 전자기학적 구성 요소
5.	전자용도를 위한 마그네트론, 웨이브 가이드, 순환기, 커플러, 절연체, 필터, 자석, RF 구성 요소
6.	인쇄 회로 기판(PCB), PCB 라미네이트, 프리페그, 포토폴리머 필름, PCB 인쇄 잉크; 인쇄 유연 전자 장치
7.	전자 용도를 위한 센서, 변환기, 발동자 및 결정체
8.	카메라 모듈, 바이브레이터 모터/링거
9.	USB/데이터 케이블, HDMI 케이블
10.	SPECS 가 적용되는 모든 상품의 자본재

#### B. INR 15 크로르 (1,970,130 USD)의 최소 투자 임계값 한계를 가진 상품 목록

번호	상품설명
1.	유효 성분 a. 트랜지스터, 다이오드 등을 포함한 개별 반도체 장치

W-18/30/2019-IPHW-MeitY

전자정보기술부

(IPHW 부서)

	b. FETs, MOSFETs, Thyristors 등을 포함한 전력 반도체
2.	실리카와 광섬유의 프리폼
3.	디스플레이 조립 및 터치 패널 / 커버 유리 조립

C. INR 25 크로르 (3,283,540 USD)의 최소 투자 임계값 한계를 가진 상품 목록

번호	상품설명
1.	마이크로 전자 기계 시스템(MEMS) 및 나노 전자 기계 시스템(NEMS)과 같은 마이크로/나노 전자 부품
2.	조립, 테스트, 표시 및 포장(ATMP) 단위

D. INR 75 크로르 (9,850,630 USD)의 최소 투자 임계값 한계를 가진 상품 목록

번호	상품설명
1.	전자용도를 위한 기계(플라스틱 및 금속 부품)

E. INR 250 크로르 (32,835,400 USD)의 최소 투자 임계값 한계를 가진 상품 목록

번호	상품설명
1.	GaN, SiC, GaA 등과 같은 화합물 반도체와 실리콘 포토닉스 장치/집적회로, 광전자 부품

F. INR 500 크로르 (65,670,800 USD)의 최소 투자 임계값 한계를 가진 상품 목록

번호	상품설명
1.	반도체웨이퍼

G. INR 1000 크로르 (131,342,000 USD)의 최소 투자 임계값 한계를 가진 상품 목록

번호	상품설명
1.	로직 [마이크로프로세서, 마이크로컨트롤러, 디지털 신호 처리 프로세서(DSP), 응용 주문형 집적 회로(ASICs) 등]; 메모리; 아날로그/혼합 신호 IC 등을

**W-18/30/2019-IPHW-MeitY**

**전자정보기술부**

**(IPHW 부서)**

	포함한 반도체 집적칩(IC)
1.	전자용도를 위한 액정 표시 장치(LCD), 발광 다이오드(LED), 유기 발광 다이오드(OLED) 등을 포함한 디스플레이 제조 장치